



证券代码：300567

证券简称：精测电子

编号：2026-002

武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	博时基金于善辉、曾鹏、蔡滨、曾豪、陈鹏扬、魏立、金晟哲、肖瑞瑾、贺宝华、王远征、陈曦、金耀、王冠桥、郭永升、甘霖、杨涛、李佳、符昌铨、王赫、戴嘉佑、付伟、齐宁、赵宪成、刘扬；南方基金张磊、龙向东、吴冉颀、张晖、竺少迪、吴春林；华夏基金谢小龙；易方达蔡荣成；平安资管孙芳、胡宇舟等 40 余人（排名不分先后）
时间	2026 年 3 月 18 日、3 月 19 日
地点	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 证券事务代表：程敏女士
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：公司 2025 年整体经营情况如何？ A：2025 年，公司紧抓半导体设备国产化替代的关键窗口期，持续巩固并提升在半导体量检测领域的国内领先地位，进一步加大大了对先进制程领域（14nm 及以下）的研发投入和产品布局。随着前期高强度的研发投入进入业绩兑现期，公司技术产业化进程全面提速。报告期内，公司在半导体领域主要产品均实现规模化量产，交付能力显著增强，收入确认规模同比大幅增长。随着业务结构优化及经营效率提升，公司半导体板块盈利能力显著改善，新签订单、营业收入、净利润均同比实现大幅增长，经营质量全面向好。预计 2025 年公司归属于上市公司股东的净利润



8,000 万元—9,000 万元，比上年同期增长 181.97%—192.21%；扣除非经常性损益后的净利润 2,165.70 万元—3,165.70 万元，比上年同期增长 113.66%—119.97%。公司将于 2026 年 4 月 28 日披露《2025 年年度报告》，相关财务数据以年报审计会计师事务所审计为准。

Q2：公司半导体量检测领域发展现状如何？

A：公司半导体前道量测领域膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品均处于国内行业领先地位，其中膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备等部分主力产品已完成 7nm 先进制程的交付及验收，目前更加先进制程的产品正在验证中。在明场光学缺陷检测设备领域，14nm 先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备验收工作进展顺利，在客户端 28nm 制程工艺节点的明场缺陷检测设备已在客户端完成验收。先进制程产品占公司整体营收和订单的比例不断增加，现已成为公司业绩的核心驱动力。半导体领域目前已成为公司业绩核心，公司对整个半导体领域行业以及公司在该领域持续快速增长充满信心。

Q3：公司明/暗场光学缺陷检测设备进展如何？

A：在明场光学缺陷检测设备领域，公司目前已累计取得多台（套）正式订单，其中公司于 2023 年 8 月披露《关于签订日常经营性重大合同的公告》，公司与头部核心客户签订关于 14nm 先进制程工艺节点的明场缺陷检测设备正式订单，已于 2024 年 10 月正式交付客户，目前验收等相关工作进展顺利，设备运行情况良好。另外，在客户端 28nm 制程工艺节点的明场缺陷检测设备已在客户端完成验收；有图形暗场缺陷检测设备等其他储备的产品目前正处于研发、认证以及拓展的过程中。

Q4：公司半导体探针卡业务情况如何？

A：在半导体探针卡产品领域，公司子公司武汉精毅通电子技术有限公司全面布局悬臂探针卡、Cobra/2D MEMS 垂直探针卡、



2. 5D MEMS 探针卡、WAT 探针卡系列，具有高精度、高可靠性和高兼容性等特点，相关产品已实现关键工序自动化量产交付，能够满足不同类型芯片的测试需求，并且可以根据不同芯片的设计和测试要求进行定制，以满足客户的个性化需求。其中，2D MEMS 垂直探针卡已批量生产，并交付客户；高频悬臂探针卡已在国内头部设计公司完成验证并批量使用。

Q5：请问公司各类产品的核心零部件国产化率有多少？

A：公司核心零部件及所需国产软件大部分已实现自主研发和生产。公司始终重视半导体领域核心部件的国产化进程，持续关注并努力提升保障核心供应链安全和稳定的能力，后续公司将继续加强与国内供应商的合作，进一步提高国产品牌在供应链中的占比。

Q6：请介绍公司控股子公司上海精测购买土地使用权的情况。

A：为加快向更先进制程工艺的迭代升级，提升综合研发能力和竞争实力，进一步落实未来发展战略规划，公司控股子公司上海精测拟购买位于上海市青浦区市西软件信息园 F2-05 地块的土地使用权，并投资建设上海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目。本项目计划总投资约人民币 3.5 亿元。截至目前，上海精测已竞拍获得前述地块土地使用权，并签订《研发产业项目施工总承包合同》。

本次上海精测拟购买土地使用权，用于投资建设上海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目，以满足公司实际业务发展和实际经营的需要。通过本次项目建设，公司将进一步完善公司产品结构，提前预留工艺开发与产能扩张空间，为未来业务规模提升和新产品持续导入奠定基础，并有效缓解现有产线资源紧张状况，加快订单交付节奏，更好满足客户批量供货需求，进一步巩固公司的核心竞争力。此次投资符合公司整体战略规划和长期发展需要，对公司未来发展及综合竞争力的提升具有积极推动



	<p>作用。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 3 月 19 日